

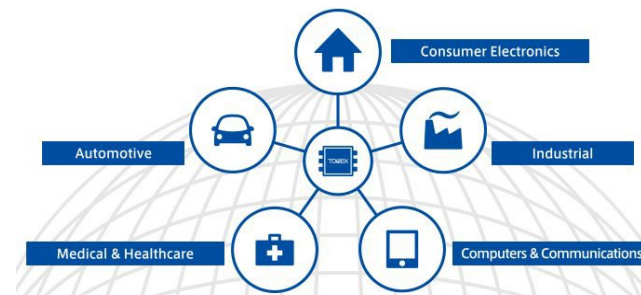
2025年3月期 第3四半期 決算説明資料

2025年2月14日

トレックス・セミコンダクター株式会社

世界は「アナログ」でできている

あらゆるフィールドで活躍するトレックスの電源IC



1

2025年3月期 第3四半期業績

2

2025年3月期 業績予想

3

株主還元

4

トピックス

Appendix

2025年3月期 第3四半期業績

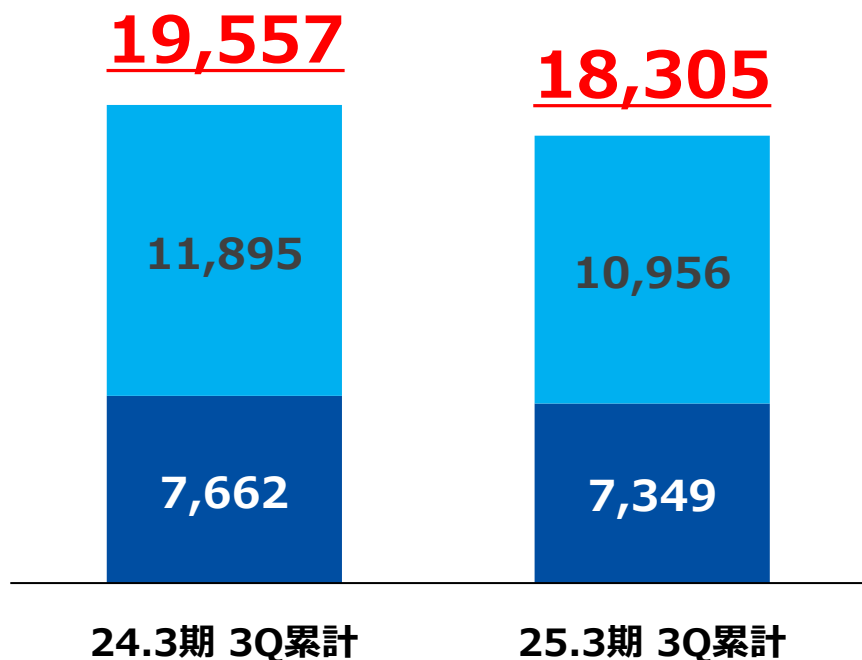
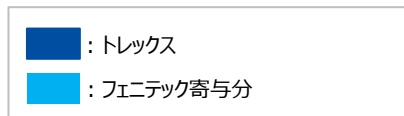
- ▶ **トレックスは、日本、欧州市場の売上が減少し減収となったが、上期の棚卸評価損の戻りと為替の影響により、増益。**
- ▶ **フェニテックは、北米市場の売上が大きく減少し、減収減益。**
- ▶ **回復を想定していた半導体需要の低迷継続を見込み、通期の業績予想を下方修正。**
- ▶ **台湾 PANJIT社と子会社持分に係る基本合意書を締結。また、自己株式の取得を発表。**

(単位：百万円)

	24.3期 3Q累計実績	25.3期 3Q累計実績	対前年同期比 増減率
売上高	19,557	18,305	▲6.4%
営業損益	▲412	▲104	-
営業損益率	▲2.1%	▲0.6%	-
経常損益	▲902	▲173	-
親会社株主に 帰属する四半期純損益	▲812	▲234	-
EPS（円）	▲73.85	▲21.30	-
海外売上高比率（*1）	67.6%	69.7%	2.1pt
平均為替レート（1\$=）	¥142.7	¥152.8	-
減価償却費	1,594	1,760	10.4%
設備投資	2,645	2,487	▲6.0%

（*1）海外売上高比率：外貨建て売上比率

(単位：百万円)



➤ トレックス

- 中国市場は回復傾向にあるものの、日本・欧州市場の落ち込みにより減収
- 産業機器、一般民生機器分野が減少

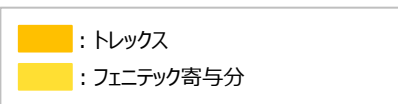
➤ フェニテック

- 北米市場が大きく減少し、減収
- 産業機器分野を中心に減少

(単位：百万円)

	24.3期 3Q累計実績	25.期 3Q累計実績	対前年同期比増減率
売上高	19,557	18,305	▲6.4%

(単位：百万円)



トレックス

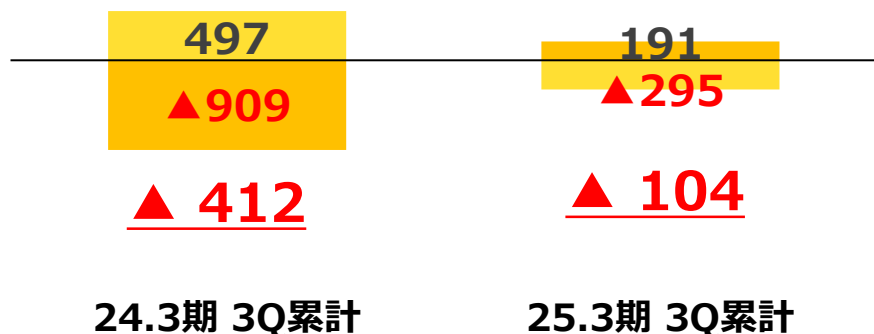
- 上期の棚卸評価損の戻りと為替の影響により、増益

※前期：棚卸評価損の発生(損) 11.7億円

当期：棚卸評価損の戻り(益) 3億円

フェニテック

- 売上の減少に伴い、減益



(単位：百万円)

	24.3期 3Q累計実績	25.3期 3Q累計実績	対前年同期比増減率
営業損益	▲412	▲104	—

2025年3月期 第3四半期業績 親会社株主に帰属する 四半期純損益



(単位：百万円)

営業損益の改善により各段階損益
が改善。
加えて、為替差損が減少し、改善。



24.3期 3Q累計

25.3期 3Q累計

(単位：百万円)

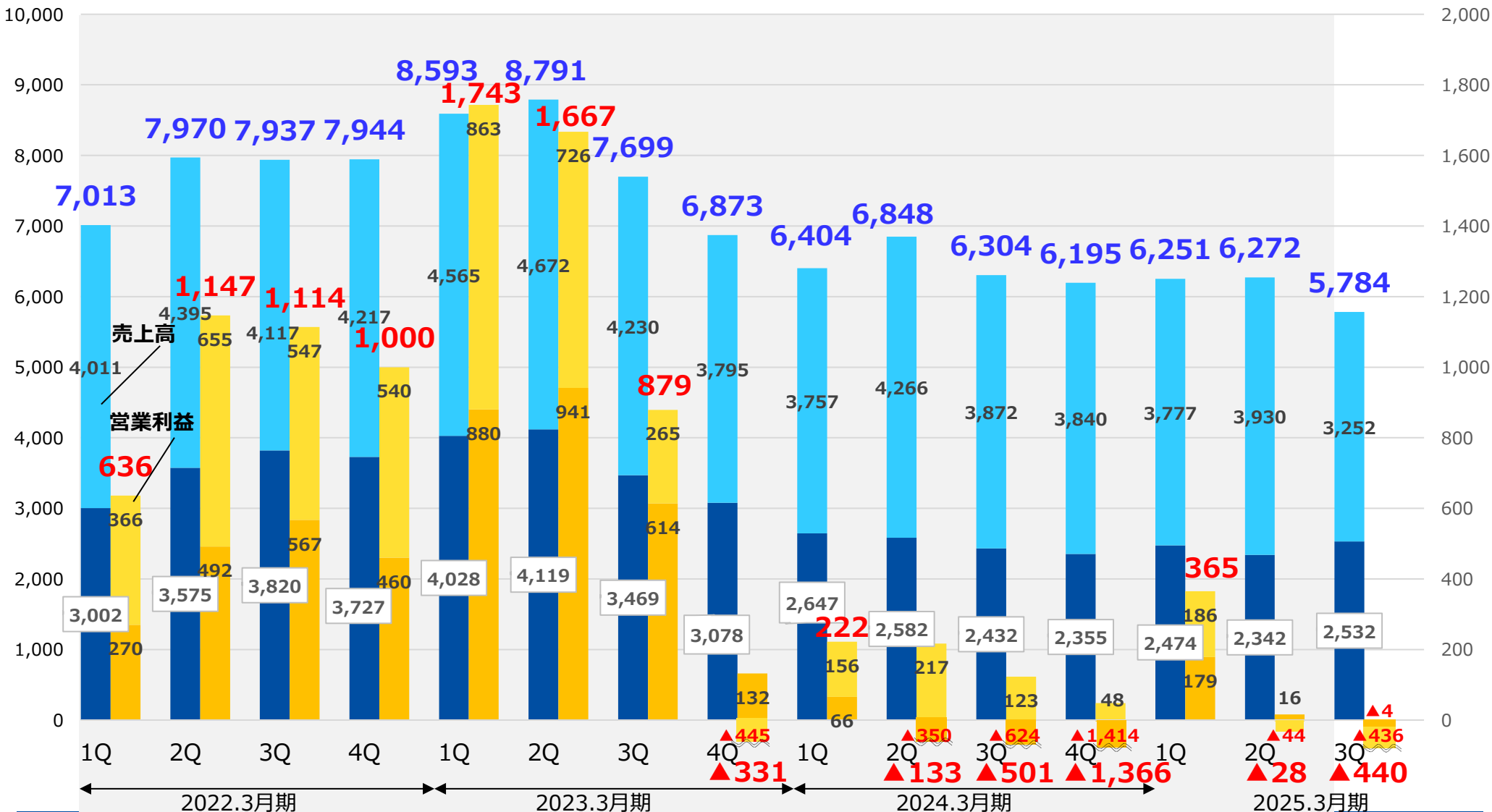
	24.3期 3Q累計実績	25.3期 3Q累計実績	対前年同期比増減率
四半期純損益	▲ 812	▲ 234	—

売上高・営業利益の四半期推移



(左軸：売上高) トレックス : ■ ■
 (単位：百万円) フェニテック : ■ ■

(右軸：営業利益)
 (単位：百万円)



(単位：百万円)

科目	24年3月期末	25年3月期 3Q末	対前期末増減
資産	36,636	37,139	503
負債	16,083	17,148	1,065
純資産	20,552	19,991	▲561

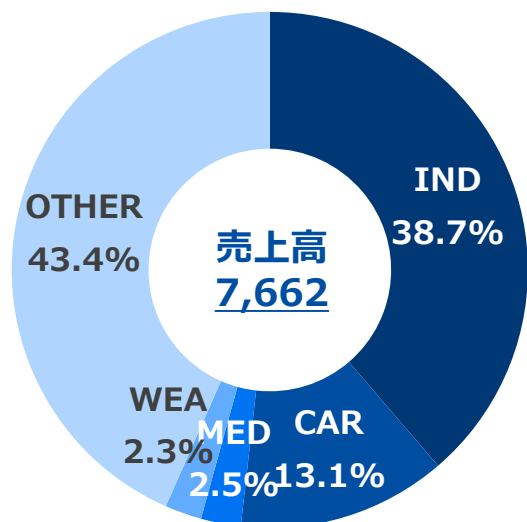
<参考> キャッシュ・フロー関連指標の推移

科目	24年3月期末	25年3月期 3Q末	対前期末増減
有利子負債	11,314	13,771	2,457
自己資本比率	56.1%	53.8%	▲2.3pt
D/Eレシオ	0.55	0.69	0.14

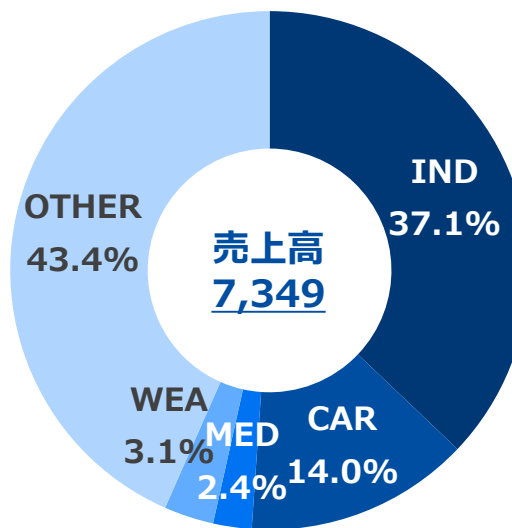
トレックス／フェニテック 各単体

2025年3月期 第3四半期業績 ～アプリケーション別売上高（トレックス）

TOIREX



24.3期3Q累計実績



25.3期3Q累計実績

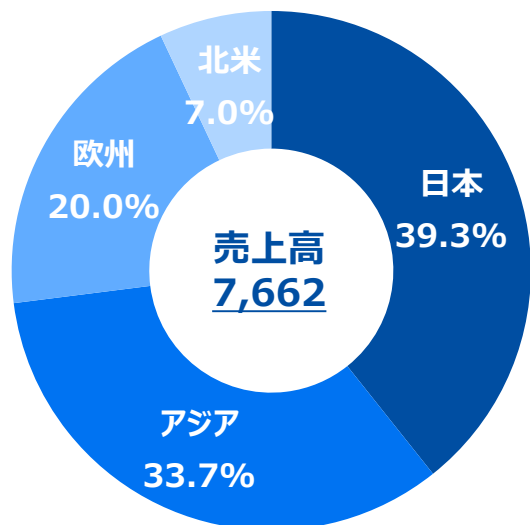
(単位：百万円)

アプリケーション	24.3期 3Q累計		25.3期 3Q累計		対前年同期比 増減率
	売上高	構成比	売上高	構成比	
IND 産業機器	2,966	38.7%	2,727	37.1%	▲8.1%
CAR 車載機器	1,002	13.1%	1,030	14.0%	2.8%
MED 医療機器	190	2.5%	179	2.4%	▲5.8%
WEA ウェアラブル機器	177	2.3%	229	3.1%	29.4%
OTHER その他機器	3,327	43.4%	3,184	43.4%	▲4.3%

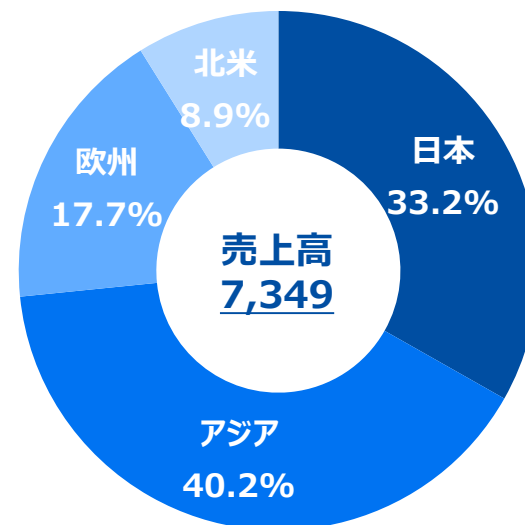
※注：アプリケーションの分類は変更することがあります。

2025年3月期 第3四半期業績 ～地域別売上高（トレックス）

TOIREX



24.3期3Q累計実績



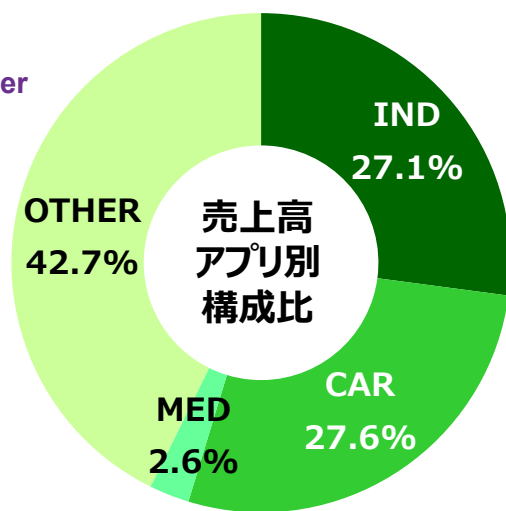
25.3期3Q累計実績

(単位：百万円)

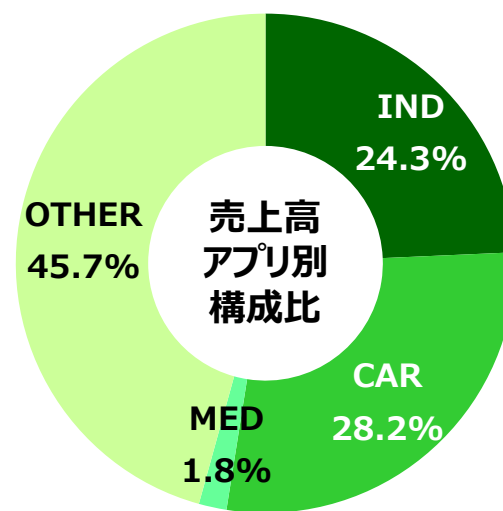
地域 (D-in)	24.3期 3Q累計		25.3期 3Q累計		対前年同期比 増減率
	D-in 売上高	構成比	D-in 売上高	構成比	
日本	3,012	39.3%	2,440	33.2%	▲19.0%
アジア	2,584	33.7%	2,953	40.2%	14.3%
欧州	1,530	20.0%	1,299	17.7%	▲15.1%
北米	536	7.0%	657	8.9%	22.6%
平均為替レート (1\$=)	142.7円		152.8円		-

D-in 売上高：デザイン・イン・ベース売上高。当社の製品を搭載した製品が企画・設計され、実質的に受注を獲得した地域をベースとした売上高

2025年3月期 第3四半期業績 ～アプリケーション別売上高（フェニテック）：参考値



24.3期3Q累計実績



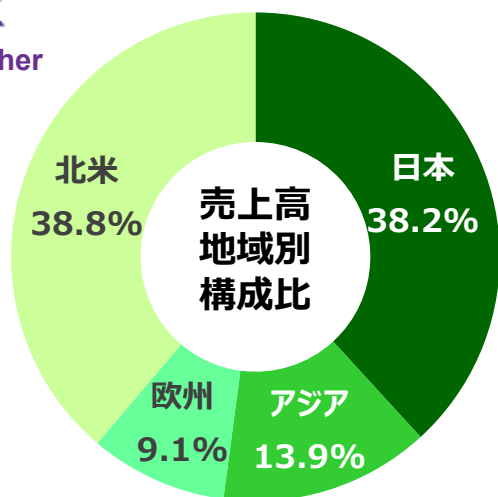
25.3期3Q累計実績

(単位：百万円)

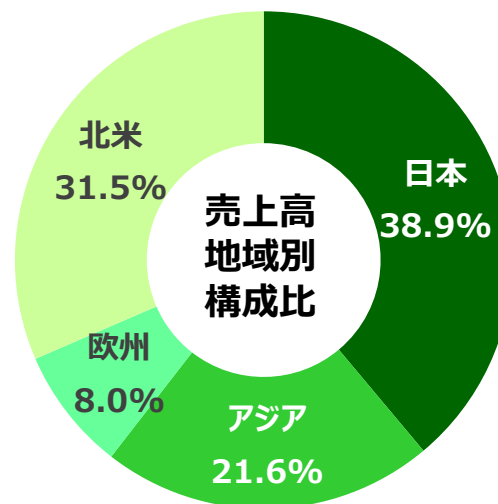
アプリケーション	24.3期 3Q累計		25.3期 3Q累計		対前年同期比 増減率
	売上高	構成比	売上高	構成比	
IND 産業機器	3,468	27.1%	2,873	24.3%	▲17.2%
CAR 車載機器	3,531	27.6%	3,330	28.2%	▲5.7%
MED 医療機器	330	2.6%	211	1.8%	▲36.1%
OTHER その他機器	5,414	42.7%	5,395	45.7%	▲0.4%

※注：アプリケーションの分類は変更することがあります。
トレックス・セミコンダクター向けの内部取引分を含む

2025年3月期 第3四半期業績 ～地域別売上高（フェニテック）



24.3期3Q累計実績



25.3期3Q累計実績

※ 顧客の所在地別に区分しています。

(単位：百万円)

地域（顧客）	24.3期 3Q累計		25.3期 3Q累計		対前年同期比 増減率
	売上高	構成比	売上高	構成比	
日本	4,874	38.2%	4,597	38.9%	▲5.7%
アジア	1,769	13.9%	2,546	21.6%	43.9%
欧州	1,158	9.1%	943	8.0%	▲18.6%
北米	4,942	38.8%	3,723	31.5%	▲24.7%
平均為替レート（1\$=）	142.7円		152.8円		

※注：日本には、トレックス・セミコンダクター向けの内部取引分を含む

2025年3月期 業績予想

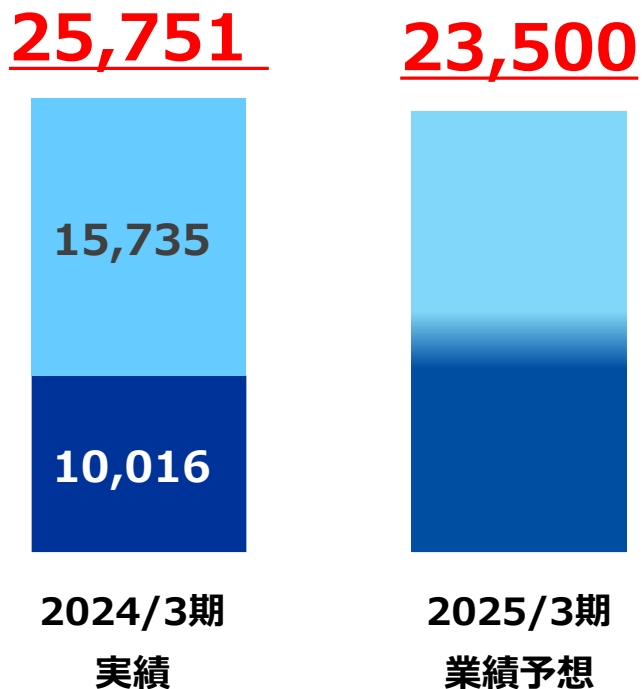
回復を想定していた半導体需要の低迷継続を見込み、
通期の業績予想を下方修正。

(単位：百万円)

	24.3期 通期実績	25.3期 業績予想	対前年 同期比 増減率	備考
売上高	25,751	23,500	▲8.7%	
営業損益	▲1,778	▲700	-	
営業損益率	-	-	-	
経常損益	▲2,452	▲800	-	
親会社株主に 帰属する当期純損益	▲4,297	▲1,000	-	
EPS (円)	▲390.73	▲90.81	-	
平均為替レート (1\$=)	¥144.4	¥150.0	-	
減価償却費	2,350	2,600	+10.6%	
設備投資	5,284	3,200	▲39.4%	

(単位：百万円)

■ : トレックス
■ : フェニテック寄与分



市況の低迷が継続し、想定していた回復に至らず、通期の業績予想を下方修正

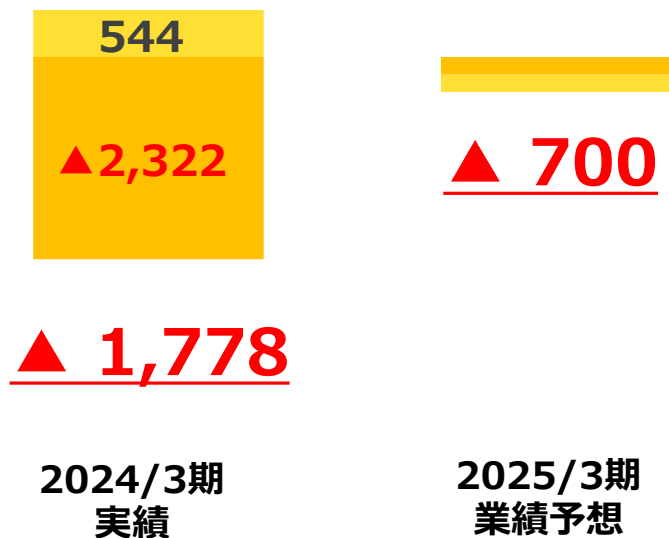
(単位：百万円)

	2024年3月期 実績	2025年3月期 業績予想	対前年増減率
売上高	25,751	23,500	▲8.7%

(単位：百万円)

- : トレックス
- : フェニテック寄与分

売上の減少に伴い、営業損益も 下方修正



(単位：百万円)

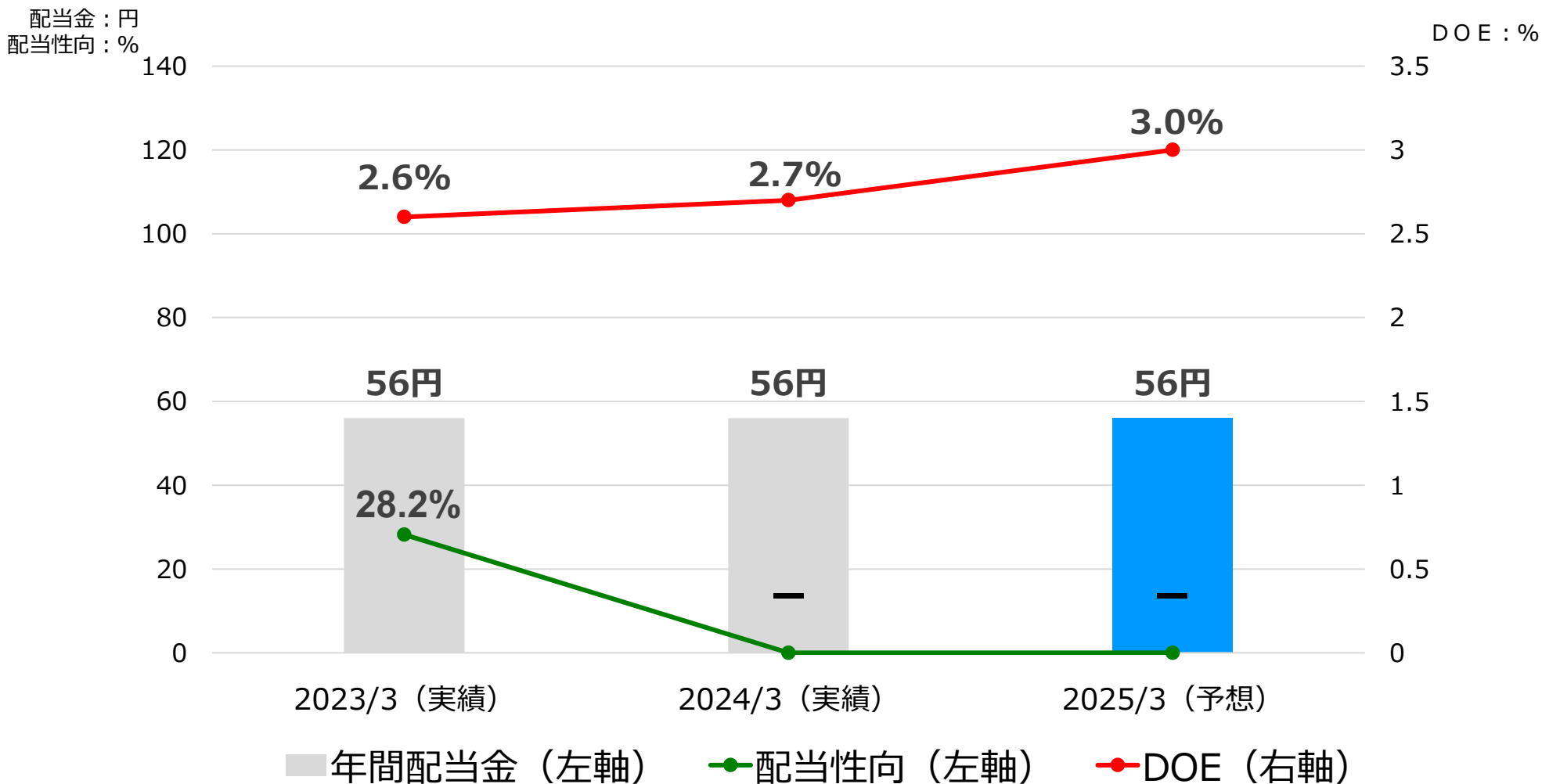
	2024年3月期 実績	2025年3月期 業績予想	対前年増減率
営業損益	▲1,778	▲700	—

株主還元

配当につきましては、業績水準を反映した利益配分として
連結配当性向20%以上、安定的かつ継続的な株主還元
の拡充として株主資本配当率（D O E）3%程度を当面
の目標として実施しております。

連結配当性向20%以上、D O E 3%程度を目標として還元

※業績予想の修正に伴う配当予想の修正はありません



トピックス

2月7日に半導体製品の世界的IDMメーカーであるPANJIT社と、 当社の後工程を行うTVS社の持分の全部または一部を譲渡する ことを目的とする基本合意書を締結したことを発表

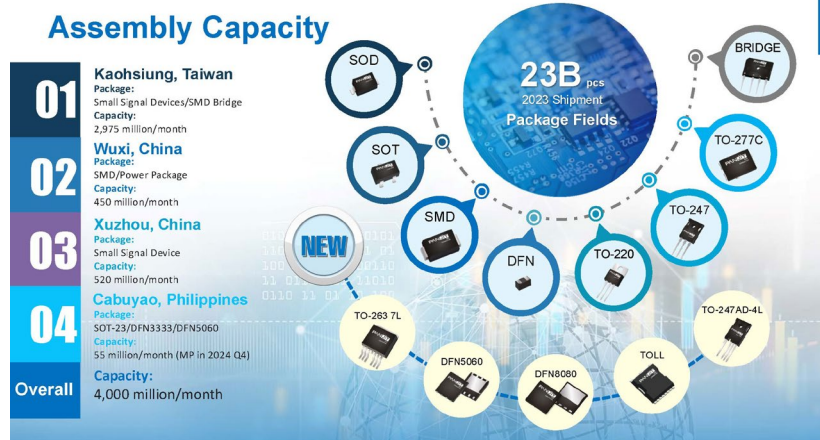
名称	PANJIT INTERNATIONAL INC.
所在地	No. 24, Gangshan N. Rd., Gangshan Dist., Kaohsiung City, Taiwan
売上高 (2023年12月期)	12,707,319千台湾ドル (597億24百万円 / 1台湾ドル=4.7円換算)
資本金	3,821,149千台湾ドル
設立年月日	1986/05/20



トックスグループのメリット

PANJIT社の製造技術力と、ファブレスメーカーである当社の設計開発力を活かし、相互にシナジー効果を発揮。

パッケージ技術の高度化と全体的な競争力を向上



※同社IR資料より抜粋

2月14日に自己株式の取得を決議

決議内容

取得する株式の総数	50万株（上限）
（発行済株式総数に対する割合 4.50%）	
株式取得価額の総額	5億円（上限）
取得期間	2025年2月17日～同年6月30日

取得理由

当社は、資本の健全性や成長のための投資との最適バランスを検討した上で、配当を基本として株主還元の充実に努める方針としております。

自己株式取得は、資本効率の向上に資する株主還元策として、投資機会、業績・資本の状況、株価を含む市場環境を考慮しながら機動的に実施いたします。

サステナビリティ基本方針

トレックスグループは、「価値ある製品を通じた豊かな社会の実現と地球環境の保全」を掲げ、環境・社会に貢献するという考えを経営の中心に据え、共存・共栄の精神で、すべてのステークホルダーとともにサステナビリティ推進に取り組んでまいります。

マテリアリティ

マテリアリティ	基本方針
社会課題解決に向けた高付加価値製品の提供	トレックスグループの製品は、世界中のあらゆる分野で使用される電子機器に広く採用されています。持続可能な社会の実現に向け、高付加価値な半導体製品を提供することで、社会課題の解決と事業の成長の両立を目指しています。
多様で個性ある人財が活躍できる環境の整備	トレックスグループの強みは、長年にわたる半導体事業で培った技術力と、市場のニーズを的確に捉える力です。この力を次世代に継承し、急速に変化する時代に対応できる専門性と独創性を備えた組織力を構築するため、人財の確保と育成を推進していきます。また、多様な個性と専門性を活かし、従業員が自発的に活躍できる職場環境の整備にも注力していきます。
地球環境保全に向けた取組の推進	トレックスグループは、気候変動を含む環境問題を、持続可能な社会の実現に向けた重要な課題と捉えています。バリューチェーンを通じて、環境負荷を軽減する半導体製品を提供することで、省エネや省資源化に貢献し、環境保全に取り組んでいきます。
すべてのステークホルダーのための経営基盤の確立	トレックスグループは、事業に携わるすべてのステークホルダーが共に繁栄することを目指しています。グループの継続的な事業成長を通じて、社会に貢献し、利益の創出を実現していきます。中長期的な企業価値の向上に向け、堅実な経営基盤を維持し、リスクマネジメントを推進することで、さらなる成長を追求していきます。

立命館大学大学院MOT学科の企業実習(プラクティカム)に受入企業として参画。

本企画は、経営学を学ぶ学生を対象とした企業実習で、実際の企業の課題抽出から、施策提案に落とし込んでいく活動を、企業の社員とともに進めていくものです。活動を通じ、実践力のある人材が育成されることをねらいとしています。



今年度は2024年12月に中間報告、2025年2月に最終報告会を実施しました。

当社は、知名度向上・学生へのリクルート活動・大学と連携した教育活動の提供という社会貢献・実習のマネジメントを通じたリーダー候補社員の育成を目的として、この企画に取り組んでいます。今回の活動では、昨今の世間情勢や半導体業界において、人材確保・人材開発といった「人」に選ばれ続ける施策が重要であること、また、その難しさを、活動を通じて参加学生のみなさまに体感いただけたかと思えます。

PWM/PFM制御 36V高耐圧 600mA 降圧DC/DCコンバータ XC9704/XC9705 シリーズ

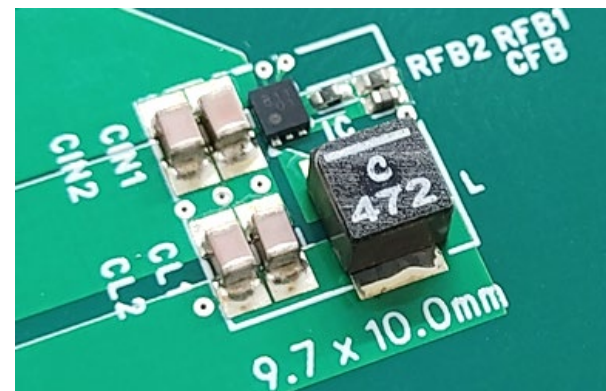
- F-PWM、PWM/PFM自動切換制御
- 同期整流 ドライバ FET内蔵
- 入力電圧範囲 3.0V ~ 36V
- SOT-89-5、DFN1820-6G

製品の特長

- 高効率、低リップル電圧
- 発信周波数：1.2MHz、2.2MHz
- パワーグッド、UVLO、ソフトスタート外調
- 電流制限、サーマルシャットダウン
- 小型ソリューションを提供

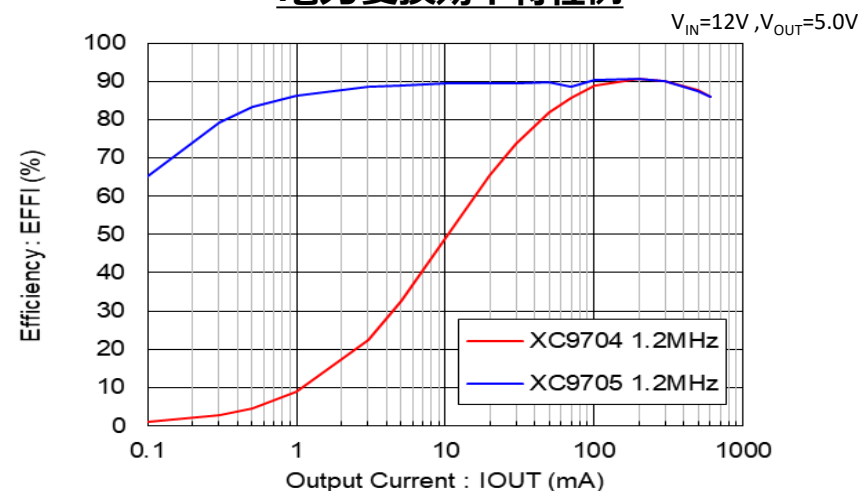
ターゲットアプリケーション

12V/24Vラインからの小型/低消費が必要な機器
工場・ビル・施設などのセンサ/セキュリティ機器
白物家電：エアコン等



36V 600mA 降圧DC/DC
小型/低消費ソリューション

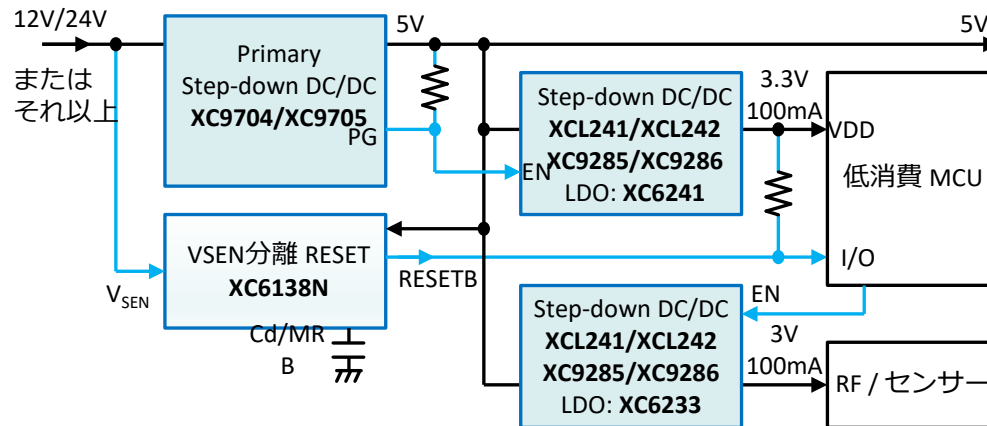
電力変換効率特性例



ターゲット市場例

- ・ 業務用エアコン、家庭用エアコン
- ・ 室内機／室外機
- ・ コントロールパネル（業務用エアコン）

⇒ 1つのセットに多員数が見込める。



注1. メーカー出荷金額ベース
注2. 2024年度以降は予測値

矢野経済研究所調べ

成長続ける空調機市場

低オン抵抗、高速スイッチング Nch MOSFETラインナップ拡充 XPJ101N04N8R、XPJ102N09N8R

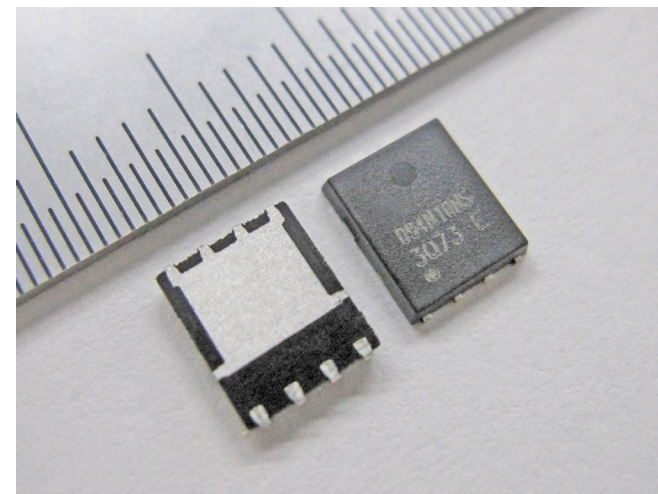
- ・ 耐圧 100V設計
- ・ 高性能とコストパフォーマンスの両立
- ・ 小型パッケージ、環境に配慮した製品
- ・ パッケージ : DFN5060-8L (6.0×4.9×h1.1mm)

製品の特長

- ・ XPJ101N04N8R 最大 4.4mΩ
- ・ XPJ102N09N8R 最大 9.4mΩ
- ・ 高速スイッチング特性

ターゲットアプリケーション

48V系DCモーター
スイッチング回路、汎用インバータ
産業機器、データセンター、サーバー
自動車関連機器



DFN5060-8Lパッケージ

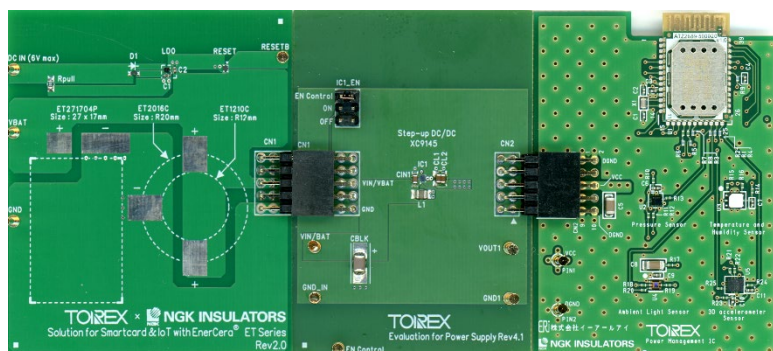
評価されているトレックス製品

(株)イーアールアイ、日本ガイシ(株)、トレックス・セミコンダクター(株) 3社の技術を組み合わせ「環境発電デモボード」を2種開発

「環境発電デモボード EsBLE」は、

- ・ 日本ガイシの超薄型・小型リチウムイオン二次電池「EnerCera®(エナセラ)」
- ・ トレックスの超低消費電源IC
- ・ イーアールアイの低消費無線化技術

を組み合わせたボードとなっており、太陽光パネル、振動発電などのエネルギーハーベストで発電した電力にて温湿度、気圧などを測定し、BLE(Bluetooth LE)で送信することが可能です。



EsBLE TYPE1

ハーベストから電池への充電基板、超低消費高効率電源基板、測定、通信、制御のシステム基板に別れており、様々な仕様での検証が可能です。



EsBLE TYPE2

必要な機能をすべて実装したオールインワンボードとなります。エネルギーハーベストを接続するだけで、各種センサーでの測定とBLEでのデータ送信が可能です。

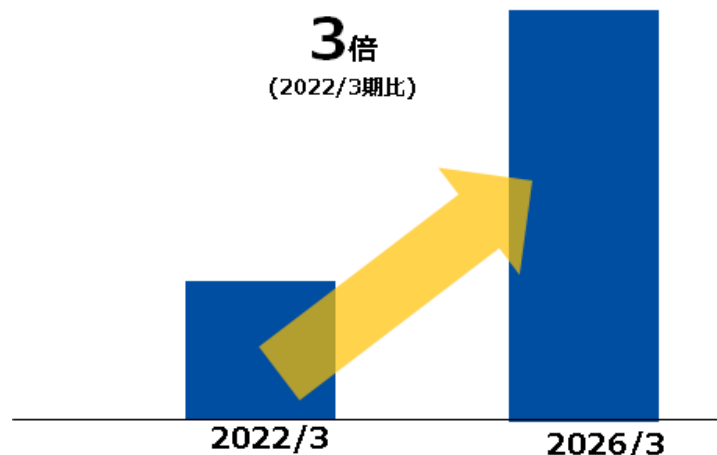
フェニテックセミコンダクター

トレックス メインFABの一つとして鹿児島工場生産能力増強

- ・ アナログ電源IC 生産能力増強
- ・ 生産能力増強に関わる設備投資
3年計画 23.3期~25.3期 総額44億円
(25.3期 投資計画最終年度 10億円)
- ・ 生産装置搬入 稼働開始

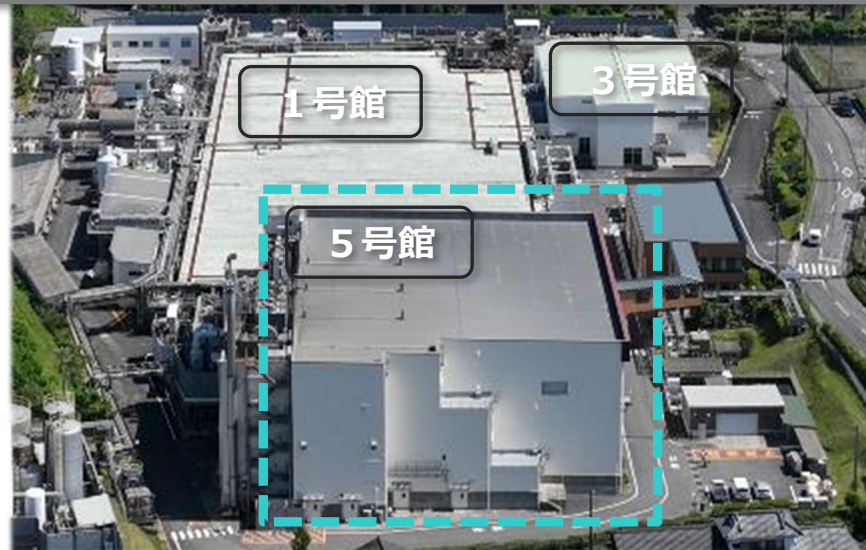


トレックス製品 生産能力枚数推移



トレックス製品の長期安定供給を実現

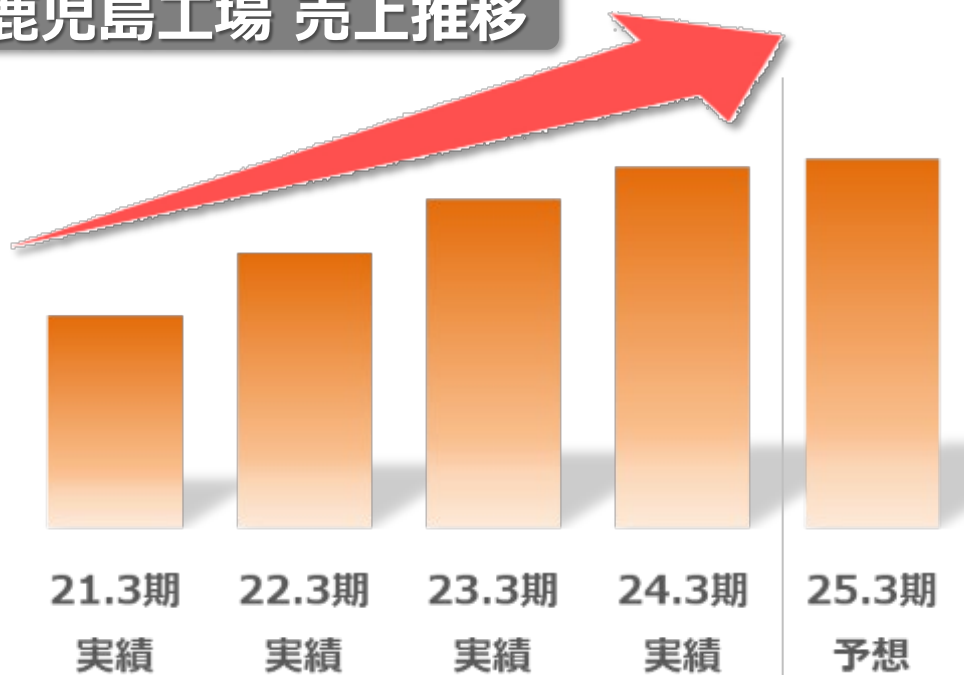
鹿児島工場5号館3階をクリーンルーム化



鹿児島工場の取組み

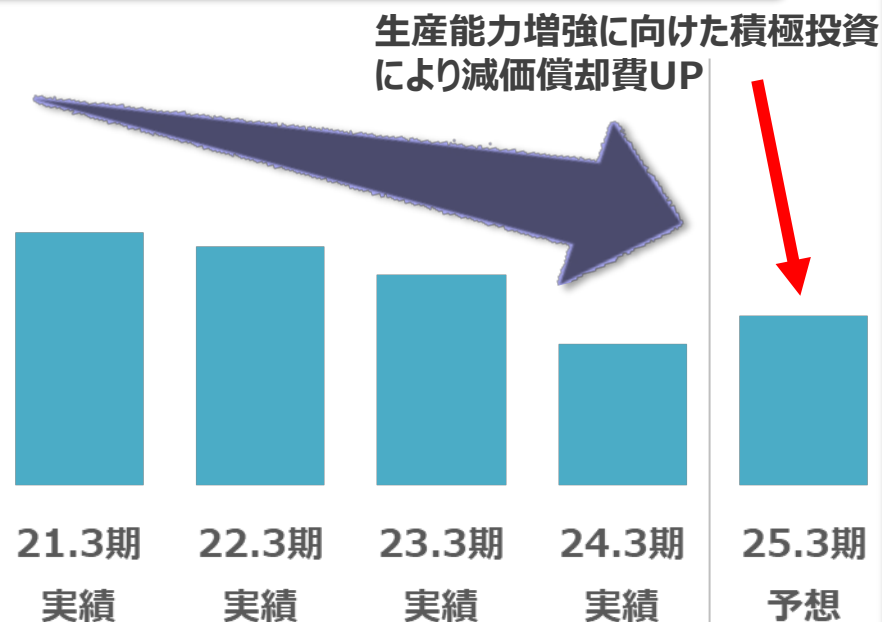
- ✓ 事業計画達成に向けた生産能力増強
- ✓ 製造固定費削減による安定した収益の確保
 - ・組織体制の改善
 - ・消耗品、修繕、消費電力削減
 - ・労働生産性向上によるCT短縮

鹿児島工場 売上推移



25.3期 2万枚/月 安定した生産体制へ

売上高に対する固定費比率推移



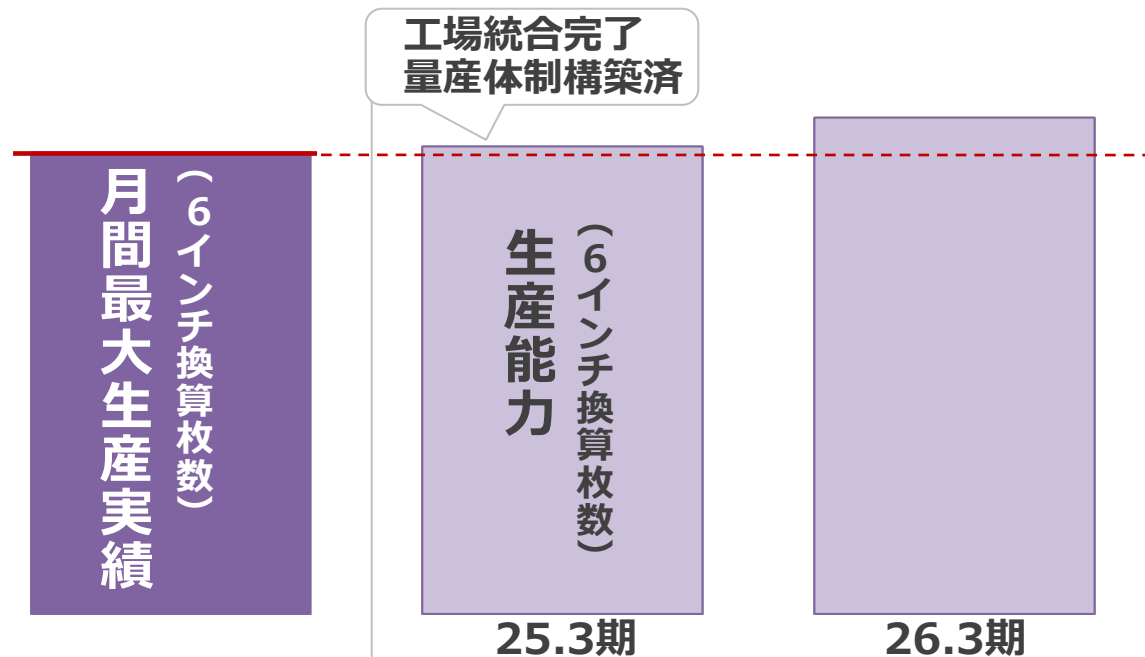
製造コスト削減により固定費比率低下

岡山工場の取組み

- ✓ 第2工場を第1工場に集約 B C P 対策と高い収益性・効率性達成
- ✓ 既存装置の生産性向上
 - ・交替勤務体制変更により働き方改革の実現と設備稼働率向上
 - ・変動費・固定費削減

岡山工場 生産実績/生産能力推移

工場統合に伴いインチサイズアップすることで生産能力を拡大



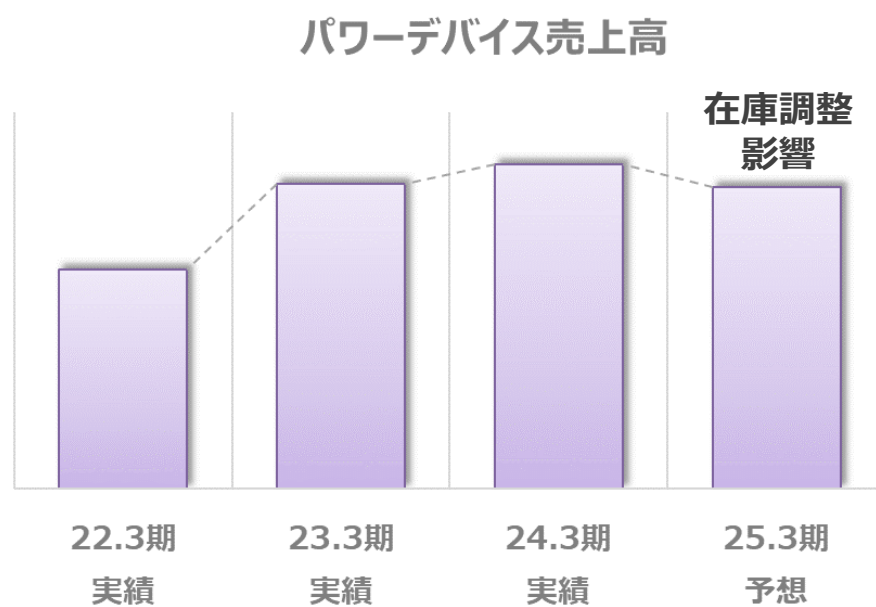
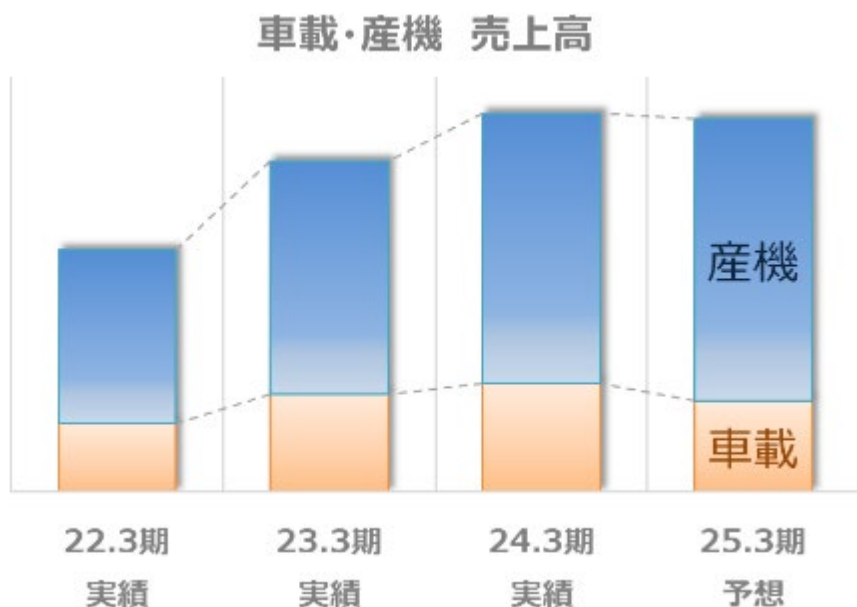
岡山第1工場



Siパワーデバイスの受注 市場の在庫調整による影響あり

要因：自動車の電動化、産業機器、5G、新エネルギーなど

デバイス：IGBT、MOSFET



化合物半導体材料に対応したプロセス技術開発 パワー半導体供給ニーズに応える

取扱い：炭化ケイ素 (SiC)、酸化ガリウム (Ga₂O₃)、窒化ガリウム (GaN)

✓市場要求に応えるパワー半導体の開発により更なる売上アップを目指す

Siパワーデバイス開発計画

24.3期

25.3期

26.3期

27.3期

新たなパワーデバイス開発により更なる売上アップを目指す



★Low Vth MOSFET 量産中

・医療系、産業系など高密度実装機器をターゲットに低電圧駆動（1.5V以下）製品を開発

・ラインナップ拡充中



★スプリットゲート型MOSFET

・非常に低オン抵抗を実現し、より小さなパッケージで高い電流密度を実現(電池の長寿命化等貢献)

・試作評価中



★フィールドストップ型IGBT

・高入カインピーダンス、高いスイッチング速度、高耐圧且つ低オン抵抗素子フィールドストップIGBTの先端性能を目指した開発

・25.3期Q4量産予定

・ラインナップ拡充を計画(電圧,電流拡大)

シナジー効果

トレックス・フェニテックはパワー半導体を共同企画・開発 このモジュール開発には、当社のパワー半導体生産技術が多分に活かされます



SiCオリジナル品

SBD

650V 10A Gen.2,3

650V 6,8,10A Gen.4

650V 20A Gen.2,3

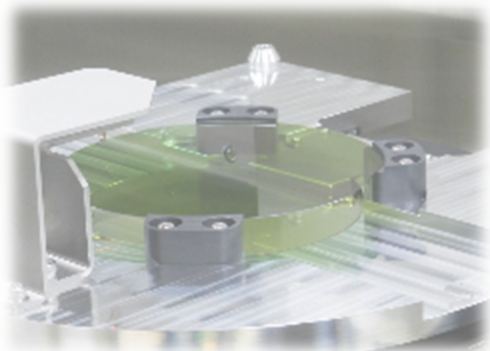
1200V 10A Gen.2,3

- ✓ 今後も市場要望にスピーディなシリーズ拡充で対応
- ・第2,3,4世代 サンプル提供中/顧客評価中

MOS FET

1200V 20A Planar/Trench

- ・プレーナー型 設計完了/サンプル提供中
✓電流ラインナップシリーズ展開 試作中
- ・トレンチ型 開発中



当社設計オリジナル品SBDは
開発を終え、
量産フェーズへ移行しました

SiCファウンドリ事業

MOSFET

- ・ファウンドリ品量産中
- ・新規顧客開拓中

➤ オリジナル品、ファウンドリ品の生産による相乗効果で
付加価値の高い製品・ウエハ加工技術を提供します

第39回ネプコン ジャパン
- エレクトロニクス開発・実装展 -

第2回 パワーデバイス&モジュール EXPO

ネプコン ジャパン パワーデバイス&モジュール EXPO に出展しました



コーポレートカラー「バイオレット」を基調とした当社ブース



開催時 当社ブースの様子

開催日

2025年1月22日(水)~24日(金)

会場

東京ビッグサイト 東7ホール

出展コンセプト

パワーデバイスファウンドリのフェニテック
~Made in Japan, Japanese quality products~

- ✓ パワーデバイス ファウンドリ会社としての知名度向上
- ✓ 自社開発のパワーデバイス開発製品紹介
- ✓ ファウンドリビジネス紹介

昨年引き続き、当社ブースにはたくさんのお客様にお立ち寄りいただき、当社の製品・サービスに対する市場の関心の高さが伺えました。

今後もお客様のご期待に応えるべく、新製品開発・サービスの向上に努めてまいります。

当社のホームページをリニューアルしました。

この度のホームページリニューアルを通じて、当社の事業や取り組みを分かりやすく
ステークホルダーの皆さまにお伝えできるように刷新しました。

コーポレートサイト

Phenitec TOP 企業情報 事業紹介 製品情報 サステナビリティ お知らせ お問い合わせ RECRUIT

For Further Growth Together

さらなる飛躍を目指して

MESSAGE

メッセージ

私たちフェニテックセミコンダクターは、
30年以上にわたるファウンドリ事業の歴史のなかで培ってきた技術力と対応力で、
多様性のある製品・プロセスを構築してきました。
その基盤を軸とし、ステークホルダーとの信頼関係を築きながら、
持続可能な成長を追求していきます。

リクルートサイト

Phenitec RECRUIT 仕事を知る 業種を知る 会社を知る 拠点を知る インタビュー FAQ コーポレート ENTRY エントリー

For Further Growth Together

フェニテックと共に飛び立とう。

あなたのその手で さらなる飛躍を。

フェニテックセミコンダクター株式会社 ウェブサイト
<https://phenitec.co.jp/>

Powerfully Small!

常に豊かな知性と感性を磨き、
市場に適応した価値ある製品を創出し、
豊かな社会の実現と
地球環境の保全に貢献するとともに、
私たちの事業に携わるすべての人々が
共に繁栄すること



Appendix 会社紹介

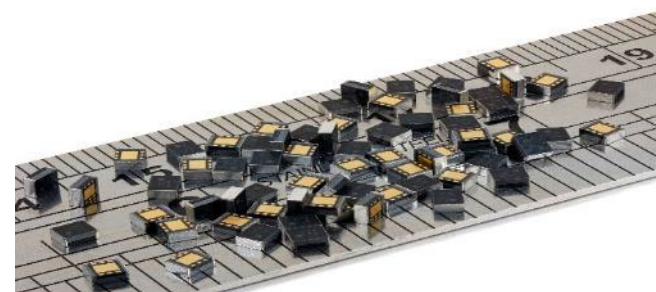
1995年に設立。2014年にJASDAQスタンダード市場に上場、東証二部、一部を経て、2022年4月に東証プライム市場に移行した半導体メーカーです。

アナログのチカラ

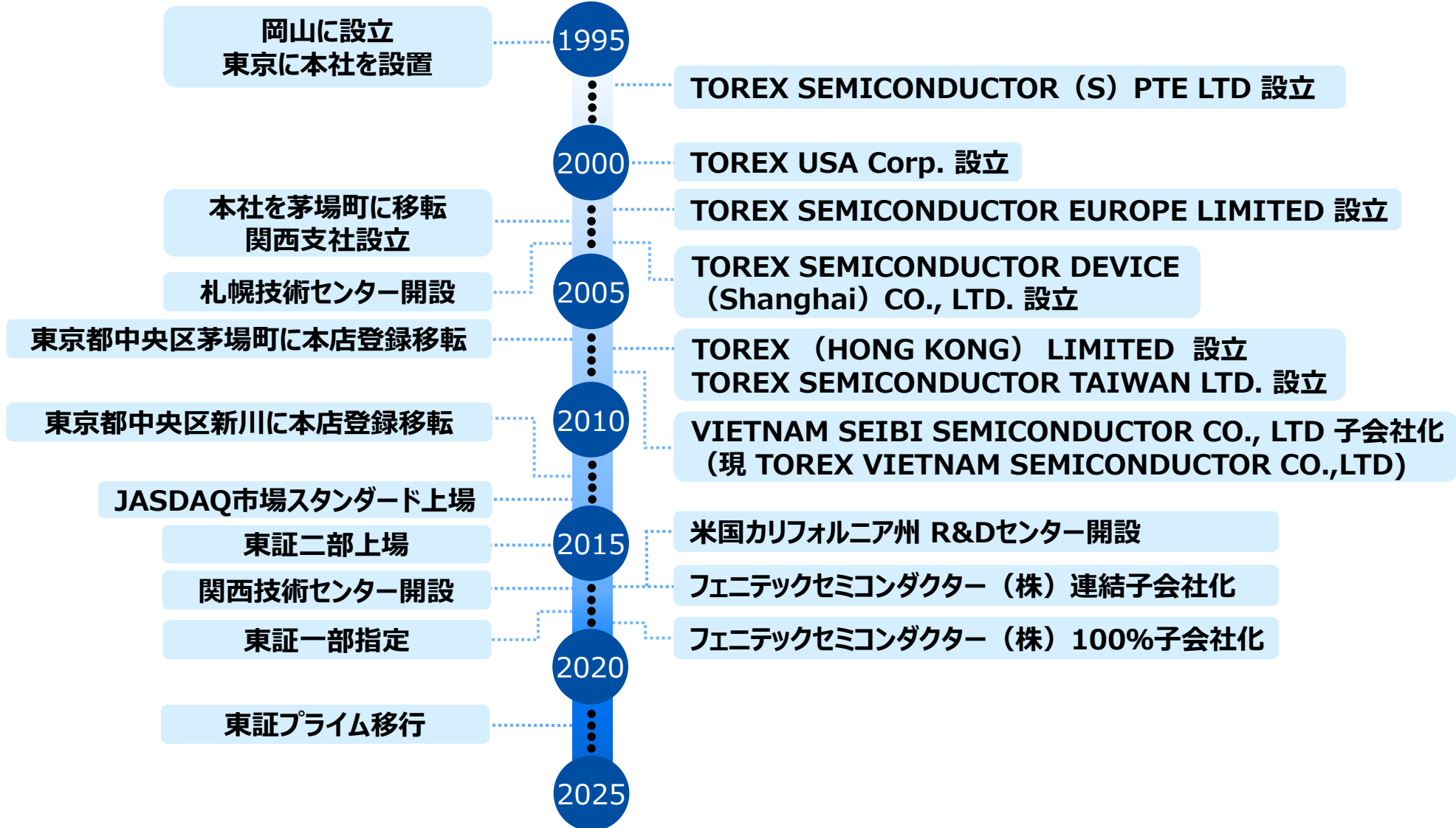
ABOUT TOREX

所在地	東京都中央区新川1-24-1 DAIHO ANNEX 3F
代表者	代表取締役社長 木村 岳史
資本金	29億6793万円（2024年12月31日現在）
事業内容	1.半導体デバイスの開発、設計製造 2.半導体デバイスの販売
従業員数	当社：189名 / グループ：1,051名
上場証券取引所	東京証券取引所 プライム市場
単元株式数	100株
決算期	3月末日
証券コード	6616
URL	https://www.torex.co.jp/

常に豊かな知性と感性を磨き、市場に適応した価値ある製品を創出し、豊かな社会の実現と地球環境の保全に貢献するとともに、私たちの事業に携わるすべての人々が共に繁栄することを企業の理念とする。



電源IC一筋、**省電力・小型化**の技術でエレクトロニクス産業の発展に貢献してきました。



TOIREX



トレックス・ セミコンダクター

**ファブレスメーカー
アナログ電源IC専業**

強み

- ・省電力／小型化の技術
- ・蓄積されたアナログ回路ノウハウ
- ・マーケティングと製品企画力
- ・フレキシブルな生産工場
- ・高品質をキープするQC
- ・ワールドワイドの製品販売網

Phenitex
For Further Growth Together



フェニテック セミコンダクター

**半導体受託専業(ファウンドリ)
ディスクリート、パワーデバイス、
CMOSアナログプロセス**

強み

- ・高品質を支える生産ノウハウ
- ・長期安定供給のJapanFab
- ・車載 IATF16949取得工場
- ・専門性の高い製造対応力
- ・オリジナルデバイスの開発力
- ・パワーデバイスの開発力



トレックス・ セミコンダクター グループ

- ・顧客第一に徹した、小回りの利く対応力
- ・積極的なコラボレーションやM&Aによる協力関係の構築

**ファブレス&ファウンドリ
それぞれが本業を突き詰めたプロ集団となり、
相互補完でシナジーを発揮する。**

- 国内に東京本社を含む 8 拠点、海外に9つの拠点を設け、世界の需要に対応しています。



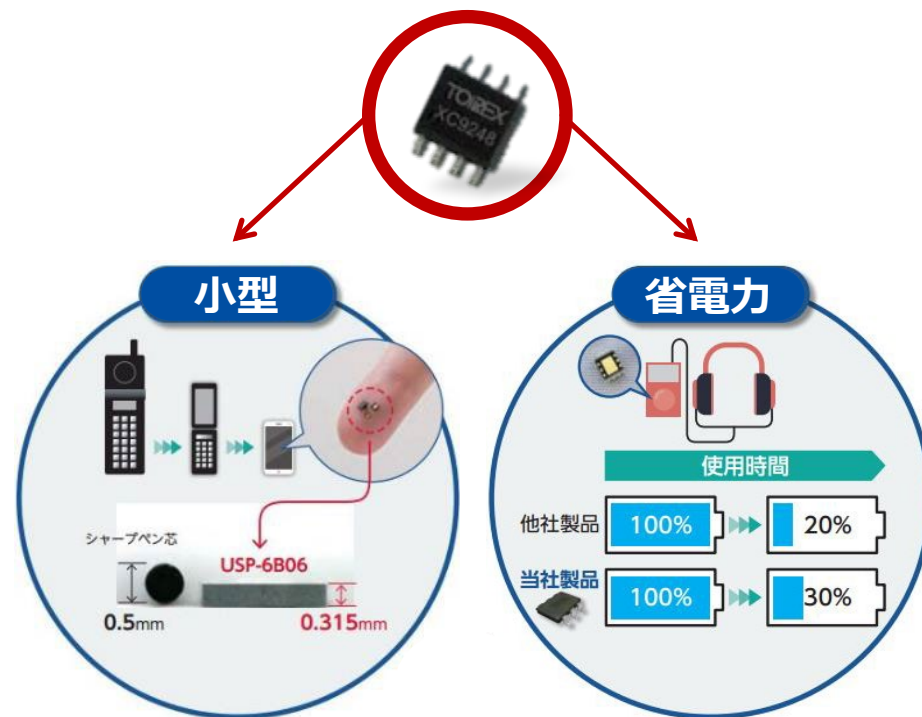
- 世界トップクラスの小型・省電力電源ICを開発・販売しています。

電源ICの役割



電子機器の様々な機能を動かすために
電圧を制御し安定供給する

TOIREXの電源IC



独自の技術で電子機器の
小型化、省電力化に貢献

	トレックス・セミコンダクター	フェニテックセミコンダクター
事業形態	ファブレス	ファウンドリ
主な製品	<p style="background-color: #FFD700; text-align: center; padding: 5px;">省エネに貢献するキーデバイスを提供</p> <p>電源IC</p>	<p>ディスクリート パワー半導体 (SiC、GaN、酸化ガリウム)</p>
今後の重点市場	<p>産業機器 5G、IoTモジュール 全固体電池モジュール</p> <p>車載機器 自動運転、ADAS、車載カメラ 電子ミラー他、様々なECU</p>	<p>産業機器 産業用ロボット、鉄道、インバータ 発電施設（風力・太陽光）、パワーコンディショナー</p> <p>車載機器 EV向けパワー半導体 電装品</p>



5G



IoT



自動運転



EV

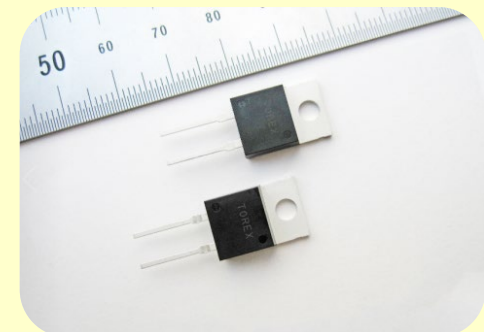
● トレックス 電源ICに加え、パワー半導体製品も強化

パワー半導体事業拡大の専任組織を設置し、強かに推進

- ・ **MOS-FET**ラインナップ拡充（低V_{th}製品、中耐圧大電流製品、低リーク）
- ・ **IGBT** 製品開発の検討
- ・ **SiC** 製品開発推進、製品の具体化
 - ⇒ **フェニテック製 SiC-SBD** トレックスよりPKG品サンプル提供中
 - ⇒ 順次、製品ラインナップを拡大
- ・ **酸化ガリウム**製品開発
 - ⇒ ノベルクリスタルテクノロジー社と共同開発

トレックスでは、フェニテックセミコンダクターが開発した、SiC ショットキーバリアダイオード 850V／10A品のサンプル提供を開始しました。

また、本製品を皮切りに順次 650V～1200Vの製品ラインナップ化を推進しております。



[SiC-SBD TO-220AC XBSC11A108CS](#)

トレックスの電源ICは、省電力/小型のスペックが評価されています。

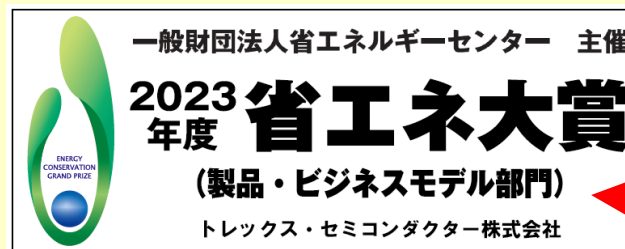
2023年度



日刊工業新聞主催

XC9145シリーズ：昇圧DC/DCコンバータ
回路の消費電流を400nAまで低減したPWM/PFM制御方式を採用することで、軽負荷時、特に数 μ Aの出力電流における電力効率を50~60%改善しました。

奨励賞
受賞



審査委員会
特別賞受賞

XC8110/8111シリーズ：ロードスイッチIC
理想的なダイオードを再現し、チップイネーブル(CE)、過電流制限、突入電流制限、サーマルシャットダウン機能等を搭載したロードスイッチICです。

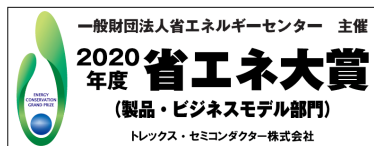
2022年度



日刊工業新聞主催

XC8110/8111シリーズ
ロードスイッチIC

2020年度



省エネルギーセンター主催

XC9276シリーズ
DC/DCコンバータ

2019年度



日刊工業新聞主催

XC9281/XC9282シリーズ
DC/DCコンバータ

2018年度



経済産業省主催

XC9265シリーズ
DC/DCコンバータ

2018年度



日刊工業新聞主催

XC6192シリーズ
ロードスイッチIC

本資料に記載された内容は、2025年2月14日現在において一般的に入手可能な情報と、合理的と判断する一定の前提に基づき、当社が作成したものです。

本資料に記載されている当社の中期計画、見通し等に関する記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクと不確実性を内包するものです。

実際の業績は、これらの要素により本資料の記載内容と大きく異なる可能性があります。

投資に関するご決定をされる際、本資料のみに全面的に依拠することはお控えいただき、みなさまご自身のご判断でなされるようお願い致します。